

铜电极表面铜锡合金电结晶机理

史纪鹏 杨防祖* 田中群 周绍民

(厦门大学化学化工学院, 固体表面物理化学国家重点实验室, 福建 厦门 361005)

Electrocrystallization of Cu-Sn Alloy on Copper Electrode Surface

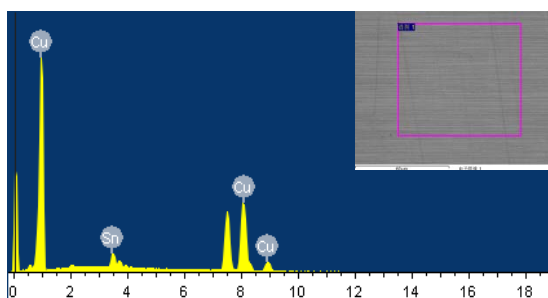
SHI Ji-Peng YANG Fang-Zu* TIAN Zhong-Qun ZHOU Shao-Min

(State Key Laboratory of Physical Chemistry of Solid Surfaces, College of Chemistry and Chemical Engineering,
Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian Province, P. R. China)

*Corresponding author. Email: fzyang@xmu.edu.cn; Tel: +86-592-2185957; Fax: +86-592-2181436.

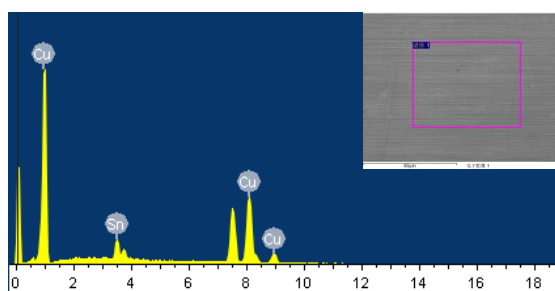
-0.45 V

元素	质量百分比	原子百分比
Cu K	88.60	93.55
Sn L	11.40	6.45



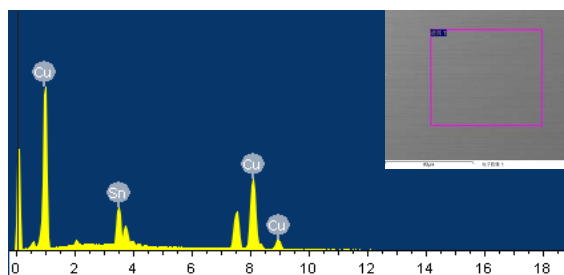
-0.50 V

元素	质量百分比	原子百分比
Cu K	84.01	90.75
Sn L	15.99	9.25



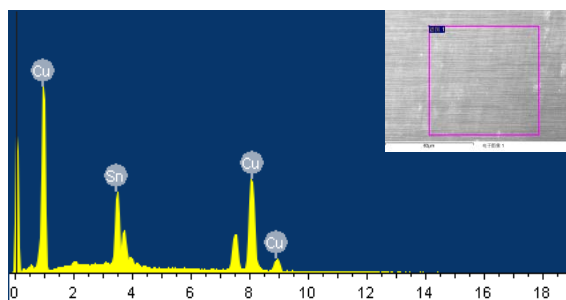
-0.60 V

元素	质量百分比	原子百分比
Cu K	74.73	84.67
Sn L	25.27	15.33



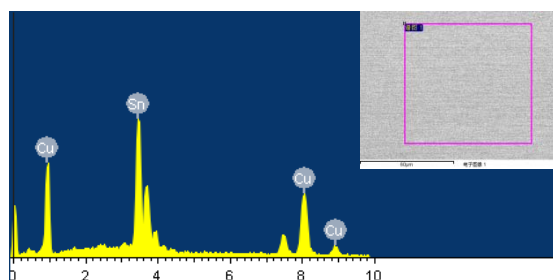
-0.70 V

元素	质量百分比	原子百分比
Cu K	67.90	79.80
Sn L	32.10	20.20



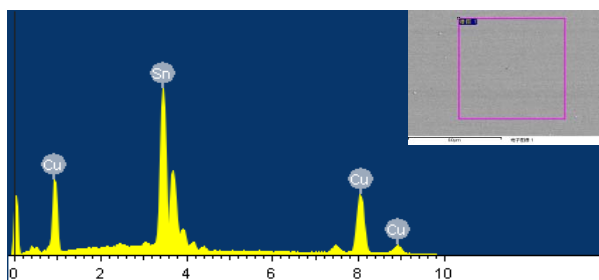
-0.80 V

元素	质量百分比	原子百分比
Cu K	44.27	59.74
Sn L	55.73	40.26



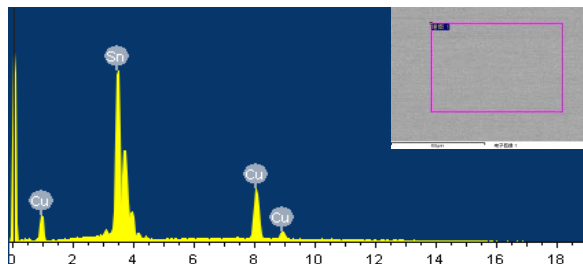
-0.81 V

元素	质量	原子
	百分比	百分比
Cu K	38.08	53.46
Sn L	61.92	46.54



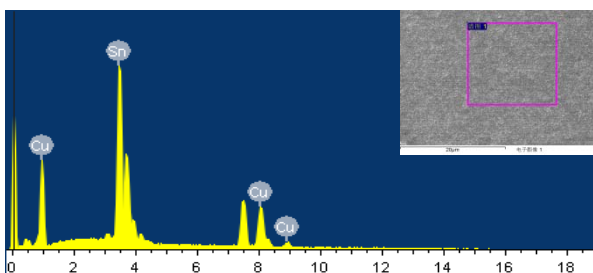
-0.82 V

元素	质量	原子
	百分比	百分比
Cu K	33.04	47.97
Sn L	66.96	52.03



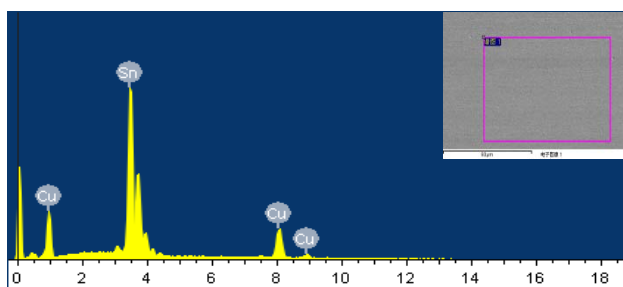
-0.83 V

元素	质量	原子
	百分比	百分比
Cu K	26.10	39.74
Sn L	73.90	60.26



-0.84 V

元素	质量	原子
	百分比	百分比
Cu K	24.42	37.64
Sn L	75.58	62.36



-0.85 V

元素	质量	原子
	百分比	百分比
Cu K	23.71	36.73
Sn L	76.29	63.27

